

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-173085

(43) 公開日 平成10年(1998) 6月26日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

H 0 1 L 23/12  
21/60

識別記号

3 0 1

F I

H 0 1 L 23/12  
21/60

F

3 0 1 A

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平8-326522

(22) 出願日 平成 8 年(1996)12月 6 日

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 染野 邦明

埼玉県深谷市幡羅町 1 - 9 - 2 株式会社  
東芝深谷工場内

(74) 代理人 弁理士 本田 崇

(54) 【発明の名称】 電子モジュール及び電子モジュールの製造方法

(57) 【要約】

【課題】 厚み規制がある電子モジュールにおいてもベアチップICの実装を容易として、前記電子モジュールの製造効率を向上させること。

【解決手段】 印刷配線板5の開口孔にベアチップIC 1を接着剤3により固定して実装しているため、ベアチップIC 1の実装厚みTは印刷配線板5の厚みtだけ薄くなる。このため、ベアチップIC 1を上から封止する樹脂の厚みが、多少厚くとも、上記した実装厚みTは規制の厚みを余裕を持ってクリアするため、上記した樹脂の封止工程を簡単化できる。このため、ベアチップICの実装が容易となつて、電子モジュールの製造効率が向上される。

